

TZB4Z100BB10B00

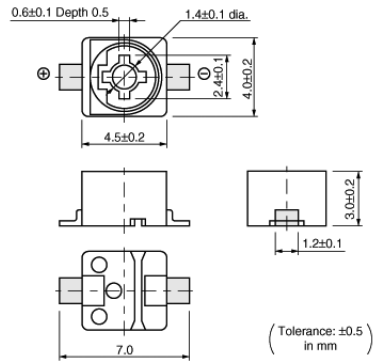
目前生产

推荐

RoHS

REACH

外观 & 形状



特点

1. Miniature rectangular shape: 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm.
2. Color coded case facilitates identification of capacitance range.
3. Designed for automatic placement in surface mount applications.
4. Designed to withstand flux baths and solder baths (with cover film type).
5. Can be temporarily attached to PCB with adhesives (Terminal style A and B).
6. Can be reflow and flow (with cover film type) soldering method.
7. Stable characteristics over a wide frequency range. (Resonant frequency: 1000MHz min. / 6pF)

包装信息

包装	规格	最小订购单位
B00	散装袋	500

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

TZB4Z100BB10B00

规格

形状	SMD	质量	0.15g
工作温度范围	-25°C to 85°C		
厚度	3mm		
厚度公差	±0.2		
额定电压	100Vdc		
静电容量最小值(max.)	3pF		
静电容量最大值	10pF		
静电容量最大值公差	+50/-0%		
调整方向	上方		
焊接方法	温度曲线(波峰) 温度曲线(回流) 烙铁		
温度特性	NP0±300ppm/°C		
Q	500min. at 1MHz, Cmax.		
耐电压	220Vdc		
绝缘电阻(min.)	10000MΩ		
力矩	1.5 to 9.8mNm		
定子/外壳颜色	White		

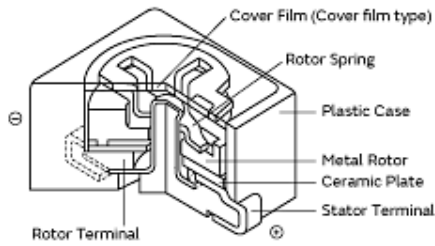
在2 / 3页

注意

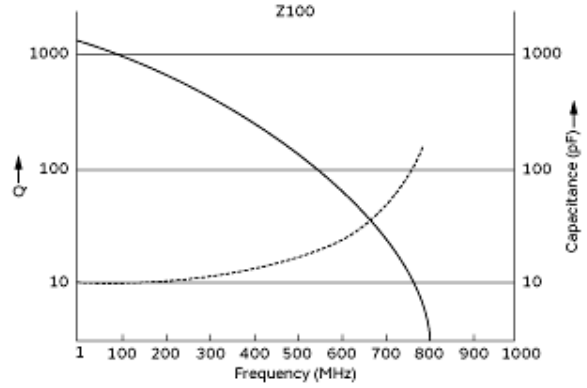
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

TZB4Z100BB10B00

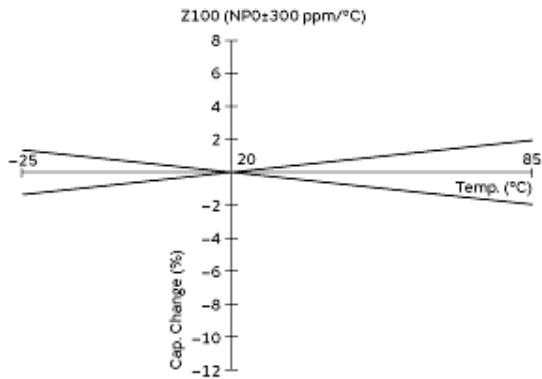
产品数据



结构



频率特性



温度特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。